



創 變 智 造 新 未 來

台達晶圓磨邊機

DWEG-3012-4



台達晶圓磨邊機

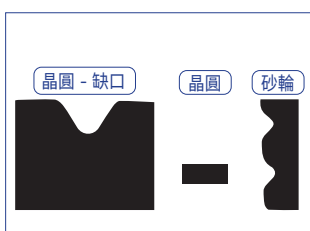
DWEG-3012-4



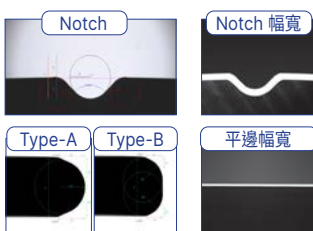
功能與特色

- 雙工位高精度研磨載台
- 高精度雷射定位系統
- 非接觸雷射量測晶圓厚度，另可選配台達輪廓儀並配置粗糙度量測模組，監控晶圓品質
- 提供 4 座卡匣輸入晶圓與多種晶圓尺寸進行加工任務 (需替換晶圓載台)
- 提供穩定安全機制設計與人性化研磨介面輸入

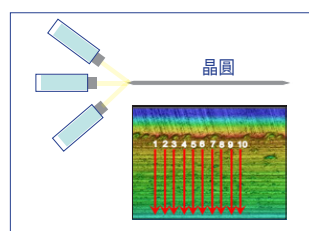
光學視覺研磨監控



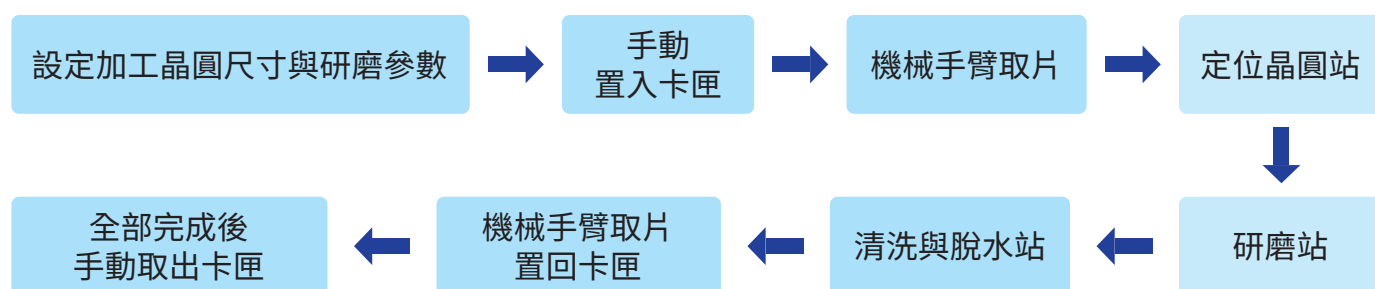
邊緣檢測功能



粗糙度檢測功能



動作流程



標準規格

型號	DWEG-3012-4
機台尺寸	約 3,000 (L) × 2,000 (W) × 2,400 (H) mm
重量	約 3,000 kg
產品尺寸	12 inch
加工產品數 / 次	1 pcs
速度	視研磨速度參數而定
I/O 介面	有
通訊介面	Ethernet
控制器	PC-based
操作介面	觸控螢幕
氣源氣壓	0.5 ~ 0.7 MPa
電源電壓	220 V _{AC} 50 / 60 Hz
產品進出方式	卡匣

* 台達保有更改規格之權力，恕不另行通知

應用領域



半導體
晶圓磨邊製程



台達電子工業股份有限公司
機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

* 本型錄內容若有變更，恕不另行通知